GdR SEEDS

Réunion du GT PCB du 13 octobre 2017

Cyril BUTTAY

Agenda

Thèses en cours :

- 10h : Yoann Pascal : enfouissement de puces dans du PCB
- 10h40 : Rémy Caillaud : Conception de convertisseur en technologie PCB enfoui

Présentations thématiques :

- 11h20 : Packaging et CEM : Pierre-Olivier Jeannin
- 12h : pause déjeuner
- 13h30 : Revue de l'enfouissement PCB : Cyril Buttay
- 14h15 : « Cuisinez vos composants magnétiques enfouis à 3DPHI »
- 15h : Point sur le GT PCB
- 16h : fin de réunion

Présents

- Yvan Avenas
- Vincent Bley
- Cyril Buttay
- Rémy Caillaud
- Nicols Ginot
- Pierre-Olivier Jeannin
- Denis Labrousse
- Stéphane Lefebvre
- Yoann Pascal
- Mickaël Petit
- David Tremouilles

Compte-Rendu

La présentation de Yoann Pascal porte sur l'utilisation de mousse métallique pour prendre le contact en face supérieure d'une puce enfouie dans du circuit imprimé, et traite des aspects de fabrication et de test de la structure.

Rémy Caillaud nous présente ses travaux sur la conception d'un convertisseur enfoui dans du PCB, avec un point particulier sur l'enfouissement des composants magnétiques et leur modélisation.

Pierre-Olivier Jeannin présente un historique des travaux réalisés au G2ELab autour de la structure "Power Chip-on-Chip", qui vise à améliorer le comportement électro-magnétique d'une cellule de commutation.

Cyril Buttay présente ensuite un état de l'art des différents aspects de l'enfouissement PCB.

Enfin, pour lancer les discussions, Mickaël Petit décrit les équipements utilisables sur la plateforme 3DPHI pour mettre en forme des matériaux magnétiques en vue de leur intégration.

Organisation du GT

Il est proposé de faire deux réunions annuelles du GT PCB, l’une avec le même format que celle de ce jour (présentations de travaux), l’autre articulée plutôt autour d’une discussion bibliographique : chaque participant fera une présentation commentée d’un article intéressant. Une première réunion de ce type est programmée pour le 23 mars 2018.

Pour la prochaine réunion "pleinière", en octobre 2018, on prévoit d’inviter un industriel pour qu’il nous présente son travail. On cherchera aussi à maintenir le GT PCB et le GT driver sur deux jours consécutifs pour faciliter les échanges.